

证券代码：002741

证券简称：光华科技

## 广东光华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260522

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（ <u>投资者网上集体接待日</u> ）
参与单位名称及人员姓名	国金证券股份有限公司、广州泓毅投资有限公司、澄澈投资及个人投资者等
时间	2026年5月22日下午15:30-17:00
地点	广东光华科技股份有限公司办公楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书杨荣政
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、介绍公司产品</p> <p>答：公司主要产品分为PCB化学品、化学试剂、高纯品锂电池材料。</p> <p>PCB化学品分为高纯化学品及复配化学品。PCB高纯化学品是以金属或含金属的化合物为主要原料，经分离提纯、化学合成等工艺制造而成的高纯电子级化合物，应用于PCB生产过程，为PCB生产的各个工序提供金属离子源。高纯化学品包括：孔金属化镀铜系列、镀镍金系列、镀锡系列等；PCB复配化学品是以多种不同功能的化学原料，通过使用复配技术、按特定的配方调配而成的配方型产品，主要应用于PCB生产各个工序，起到特定功能作用。复配化学品包括：完成表面处理系列、褪膜系列、化学沉铜系列等。</p>

化学试剂高纯品是最典型的专用化学品，是现代经济建设和科学技术研究不可缺少的基础物质材料，公司在化学试剂的分离、提纯及合成技术工艺等方面积累了丰富的经验，产品包括分析与专用试剂，产品功能主要应用于分析测试、教学、科研开发以及新兴技术领域的专用化学品。

锂电池材料是公司在多级串联络合萃取提纯技术和结晶控制等核心技术的基础上，结合国际领先的电池材料生产工艺制造出来的系列产品，具有品质稳定、高压实密度、循环稳定等特点。锂电池材料主要产品有三元前驱体及三元材料系列产品，磷酸铁、磷酸铁锂及磷酸锰铁锂系列产品，钴盐、镍盐、锰盐系列产品等。

2、请介绍一下目前公司硫化锂的情况及优势。

答：公司高纯化学品硫化锂已送样客户检测，目前处于优化阶段。公司专用化学品制造不同于大宗化学原材料制造，由于客户需求的不同导致其生产模式与大宗化学原料制造有明显的区别。不同客户对专用化学品质量、性能指标往往有不同的要求。特别是高端产品由于终端领域的特殊功能及可靠性的需要，对于化学品的杂质含量、晶体晶型、电性能等方面经常有针对性的要求。因而专用化学品一般属于非标准产品，需要根据客户的要求进行定制研发设计，但是在主体生产工艺上，例如分离提纯、结晶、合成、复配等工艺上绝大多数产品的主要生产流程大体相同或相近，生产过程趋于标准化。

公司硫化锂产品生产工艺简单，主要采用液态提纯+固态合成的路线，有效减少了杂质的引入和产物的分解，使得产品的纯度得以大幅提升，能够满足电池级硫化锂的要求。目前已申请发明专利。

3、请介绍公司氧化铜产品情况。

答：氧化铜产品是公司核心业务之一，公司是国际化高纯电子级氧化铜的领先供应商。

产品特点：氧化铜金属杂质极低，酸不溶性物质极少，具有独特的竞争优势。其产品呈规则球形颗粒，流动性好，表面疏松结构使其溶解速度极快，可及时补充铜离子，适合高精细路、高可靠性产品电镀要求。

生产工艺：公司建成国内首条氧化铜全自动化生产线，以高纯电解铜为原料，通过先进的自动化和数字化管理系统，实现了生产过程的精准控制。

应用领域：产品广泛应用于手机、笔记本电脑、汽车及存储设备等高端消费电子产品和通信领域，在半导体封装、IC 载板、HDI 板、FPC 板及 SLP 等领域占据重要地位。

4、介绍一下公司封装基板关键物料。

答：主要针对封装基板高端镀铜关键物料、设备及工艺技术进行开发，攻克了封装基板盲孔及 X 型激光通孔填孔能力不足的行业共性问题。子公司东硕科技通过自主设计与合成的核心原物料，研发出两款适用于 IC 封装基板电镀工艺的酸铜添加剂产品，可满足图形电镀和整板电镀中，盲孔填充和 X 孔填充两类应用场景的高端电镀需求，解决了电镀添加剂与设备兼容性、工艺适配及产线规模化应用中的关键技术难题。

通过本项目的实施，成功打破了国外企业在封装基板电子化学品领域的长期垄断，实现了核心产品的国产化替代，有力提升了我国高端封装基板产业链的自主可控能力。项目执行期内，东硕科技建成了封装基板高端镀铜试验线，相关产品通过多家客户端的应用验证并获得高度认可，展现出良好的适配性与稳定性，实现了高端镀铜相关产品的稳定生产与批量应用。

5、介绍一下公司玻璃基封装基板关键技术。

公司依托其在高端电子化学品及先进封装材料领域的技术积淀，自主研发适用于超高深径比的金属化填孔工艺与配套材料，着力解决空洞控制与表面形貌调控难题，为玻璃基

封装基板的高可靠互连奠定核心工艺基础。

主要解决面临的三大技术挑战：一是 PVD 溅射深孔能力不足，导致种子层覆盖不完整，在孔中间存在断铜风险；二是高深径比结构易导致电镀液流动受阻，孔中心铜离子补充不足，再加上电流密度在孔口（边缘和拐角）处最高，导致铜离子优先在孔口快速沉积，一旦过早闭合，就会把电镀液和气泡包裹在孔中心，形成致命的空气间隙或孔洞；三是铜与玻璃的热膨胀系数严重不匹配，在电镀填充过程中，如果内部产生过大的热应力，极易导致脆性的玻璃基板发生翘曲甚至开裂。

6、国内高端 PCB 化学品仍依赖进口 30%以上，公司如何突破高端电子化学品、高纯试剂等“卡脖子”领域？

答：公司在研发上持续投入以突破“卡脖子”领域，如“高端镀铜添加剂及其应用技术的研发及产业化”项目，通过应用基础研究，揭示镀层微纳组织调控方法及其与可靠性构效关系，突破高端镀铜核心原料分子结构合成、多物理场添加剂配方设计等关键技术，形成高端镀铜核心添加剂配方，实现产业化并建立相关行业标准。此外，在专化品领域，氟化亚锡突破大规模生产技术难题，溴化亚铜以新技术路线实现大规模稳定生产。

7、介绍公司电子化学品客户情况。

答：公司定位为高端专用化学品整体解决方案提供商，经过多年的市场开拓和客户维护，公司已拥有一大批合作关系稳定的优质客户，如 PCB 客户美维电子、健鼎、霍尼韦尔、杜邦材料、中京电子、生益电子、三星、兴森快捷、胜宏科技、瀚宇博德、MK；专化品客户上海如鲲、确信乐思、比亚迪、高露洁、禾元生物、好来化工等世界 500 强企业或知名的跨国企业。

8、请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：电子化学品行业在新兴技术发展、国家政策支持和

	产业升级需求驱动下，国产替代进程加快，行业整体态势良好，未来有望迎来更广阔空间。化学试剂行业随着国家对自主创新产业投入加大，市场需求和产品质量要求不断提高，发展前景广阔。
附件清单（如有）	无
日期	2026年5月22日